

Total Grinding Solutions

お客様の課題、応える技術、躍動と実感…ジェイテクトマシンシステム

JIMTOF2024

11月5日(火)～11月10日(日)
東京ビッグサイト

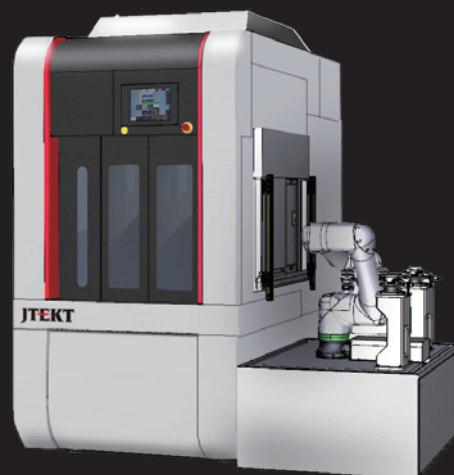
工作機械

東3 ホール
E3014

立形研削盤

VGF300 工程集約 汎用複合研削

ツールチェンジ、プローブセット、ワーク搬入出を
協働ロボットでハンドリング自動化。
多様なワークを連続研削できる多工程研削盤の省人化モデル。
制御盤は、本体から別置可能なレイアウトフリー。



立形両頭平面研削盤

KVD300II 高能率研削 砥石周速クラス最高

といし径 $\phi 305\text{mm}$ $3,000\text{min}^{-1}$ は、クラス最高。
短時間 高能率研削を実現。
放電ドレス搭載で、
鋭利な砥粒形状を成形。
メタルボンド砥石の
脱着回数減少による
コスト低減。



センタレス研削盤

KCL50 極細 1工程 多段成形加工

$\phi 0.2\text{mm} \sim 5\text{mm}$ を1工程で多段成形加工。
医療・精密部品にベストマッチ。
放電ドレス搭載で、鋭利な
砥粒形状を成形。
メタルボンド砥石の
脱着回数減少による
コスト低減。



Precision Mechanical Equipment

お客様の課題、応える技術、躍動と実感…ジェイテクトマシンシステム

精密機器

JIMTOF2024

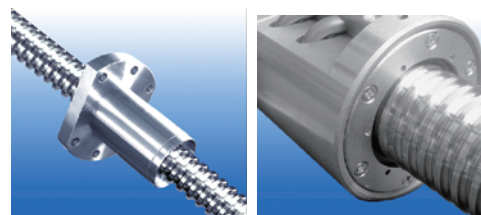
11月5日(火)～11月10日(日)
東京ビッグサイト

西2ホール
W2047

ボールねじ スピンドル インデックスチャック

ボールねじ

「コンパクトタイプ」は、ナット長さを約25%、
ナット外径を約20%サイズダウン。
「高密封タイプ」は、異物の混入と潤滑材の流出を防ぎ、
メンテナンスインターバルを向上。

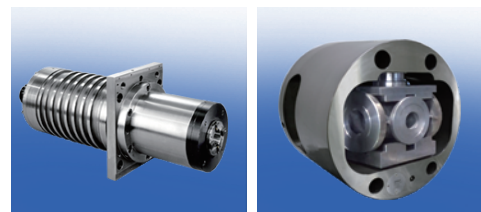


コンパクト

高密封

スピンドル

モーター内蔵で高速回転、コンパクト化を実現した高性能スピンドル。



ビルドインスピンドル

インデックスチャック

インデックスチャック

大物ワーク対応「Model: HSR500」

特殊環境・半導体装置 クリーンプロ[®]

コーティング ボールねじ

クリーンプロ[®]

フッ素コーティングによる潤滑膜の
潤滑性、耐久性を向上させ、
クリーン環境での発じん、
放出ガスの発生を
極限まで低減。



特殊環境・半導体装置

エアスピンドル

静圧空気軸受による非接触回転により
高速回転、高精度、熱的安定性
長寿命という特性から
硬脆材料や軟質金属等の
超精密加工を支える
エアスピンドル。
出展ブースの
エアテーブルに
直接触れてエア軸受を実感して下さい。

